



台積公司宣布有意增加在美投資金額至1,650億美元以驅動人工智慧未來

台積公司計畫增加1,000億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2025年3月4日

台灣積體電路製造股份有限公司今日（美國當地時間3日）宣布有意增加1,000億美元投資於美國先進半導體製造。此前，台積公司正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積公司在美國的總投資金額預計將達到1,650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案（single foreign direct investment）。

透過本次擴大投資，台積公司預期為人工智慧（AI）和其他前瞻應用創造數千億美元的半導體價值。台積公司的這項擴大投資也預計在未來四年為約40,000個營建工作機會提供支持，並在先進晶片製造和研發領域創造數以萬計高薪且高科技的工作機會。預計在未來十年，這項投資還將推動亞利桑那州和美國各地超過2,000億美元的間接經濟產出。此舉突顯了台積公司致力於支持客戶，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等美國領先的AI和科技創新公司。

台積公司董事長暨總裁魏哲家博士表示：「回顧2020年，由於川普總統的願景和支持，我們開始了在美國設立先進晶片製造的旅程，這項願景現在已成真。AI正在重塑我們的日常生活，半導體技術是新功能和應用的基石，隨著台積公司在亞利桑那州的第一座晶圓廠取得了成功，以及必要的政府支持和強大的客戶合作夥伴關係，我們擬增加1,000億美元投資於美國半導體製造，這讓我們的計畫投資總額達到1,650億美元。」

台積公司的亞利桑那州晶圓廠占地1,100英畝，目前聘有3,000多名員工，並已於2024年底開始量產。此次擴大投資將增加美國生產之先進半導體技術，對強化美國半導體生態系統至關重要，而台積公司在美首次的先進封裝投資也將完善美國國內的AI供應鏈。

在美國，台積公司除了設於鳳凰城的最新製造據點，亦在華盛頓州卡默斯（Camas）設有一座晶圓廠，並於德州奧斯丁（Austin）和加州聖荷西（San Jose）設有設計服務中心。



關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2024 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 288 種製程技術，為 522 個客戶生產 1 萬 1,878 種不同產品。台積公司企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

TSMC Spokesperson:

Wendell Huang
Senior Vice President and CFO
Tel: 886-3-505-5901

TSMC Media Contacts:

Nina Kao
Head of Public Relations
Tel: 886-3-563-6688 ext.7125036
Mobile: 886-988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com